



# 平成31年3月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成30年8月9日

上場会社名 株式会社 岡本工作機械製作所

上場取引所 東

コード番号 6125 URL <http://www.okamoto.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 石井 常路

問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員 管理本部長 (氏名) 高橋 正弥

TEL 027-385-5800

四半期報告書提出予定日 平成30年8月10日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成31年3月期第1四半期の連結業績(平成30年4月1日～平成30年6月30日)

### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
31年3月期第1四半期	6,871	21.1	526	409.1	450	557.8	346	823.1
30年3月期第1四半期	5,675	40.9	103		68		37	

(注) 包括利益 31年3月期第1四半期 313百万円 (180.9%) 30年3月期第1四半期 111百万円 (%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
31年3月期第1四半期	82.27	
30年3月期第1四半期	8.49	

(注) 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、「1株当たり四半期純利益」を算定しております。

### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
31年3月期第1四半期	31,774	9,718	30.6
30年3月期	31,346	11,326	36.1

(参考) 自己資本 31年3月期第1四半期 9,718百万円 30年3月期 11,326百万円

## 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
30年3月期		2.00		50.00	
31年3月期					
31年3月期(予想)		40.00		40.00	80.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。平成30年3月期の1株当たり期末配当金については、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「-」として記載しております。株式併合後の基準で換算した平成30年3月期の1株当たり年間配当金は70円となります。

## 3. 平成31年3月期の連結業績予想(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	16,000	16.4	1,100	37.9	950	36.5	750	45.9	187.22
通期	32,000	11.0	2,600	28.9	2,350	37.7	1,650	16.8	411.88

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

当社は、平成30年5月15日開催の取締役会決議に基づき、自己株式416,100株の取得を行いました。連結業績予想の「1株当たり当期純利益」については、当該自己株式の取得の影響を考慮しております。

## 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- |                    |     |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| 以外の会計方針の変更         | : 無 |
| 会計上の見積りの変更         | : 無 |
| 修正再表示              | : 無 |

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	31年3月期1Q	4,717,895 株	30年3月期	4,717,895 株
期末自己株式数	31年3月期1Q	712,458 株	30年3月期	295,745 株
期中平均株式数(四半期累計)	31年3月期1Q	4,213,802 株	30年3月期1Q	4,425,651 株

(注)当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」を算定しております。

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

## 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

### 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項については、添付資料2ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(追加情報)	7
(セグメント情報等)	7
3. 補足情報	8
受注及び販売の状況	8

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、米国では設備投資や個人消費の増加により拡大基調が続き、欧州でも企業業績の好調さを背景に、景気は回復基調が継続いたしました。アジアでは、中国をはじめ、その他の新興国も一定の成長を維持しました。

わが国経済は、好調な企業収益を背景として、設備投資の増加や雇用の改善などが継続し、景気は安定して推移いたしました。しかしながら、海外諸国の保護主義政策の動向など、景気の先行きに不透明感の残る状況も続いております。

このような状況の中で当社グループは、今期が最終年度となる中期経営計画「Mission GX 2019」の達成のため、国内外の販売シェア拡大やQCD改善活動によるコストの削減などに注力し、グループの総合力を駆使して、業績向上に努めてまいりました。その結果、当第1四半期連結累計期間における連結売上高は6,871百万円（前年同期比21.1%増）、営業利益は526百万円（前年同期比409.1%増）、経常利益は450百万円（前年同期比557.8%増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は346百万円（前年同期比823.1%増）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりです。

## ① 工作機械

国内市場におきましては、工作機械業界や金型業界向けに円形平面研削盤、また幅広い業種で精密平面研削盤の需要が高まり、売上高は前年同期を上回りました。受注につきましても、工作機械業界や精密金型業界向けに大型平面研削盤などが引続き好調で、前年同期を上回る結果となりました。

海外市場におきましては、米国では航空機や医療機器などの業種を中心に販売、受注ともに堅調に推移いたしました。欧州では、前期に続いてフランス、イタリアなどで汎用タイプの平面研削盤の需要が続き、あわせて大型平面研削盤を受注するなど、販売、受注ともに前年同期を上回りました。アジア市場におきまして、中国では自動車関連、工作機械関連向けの精密金型や自動化設備などへの投資需要が旺盛で、大型研削盤や特殊研削盤などの受注もあり販売、受注ともに前年同期を上回りました。

以上の結果、売上高は5,397百万円（前年同期比16.7%増）、セグメント利益（営業利益）は343百万円（前年同期比170.5%増）となりました。

## ② 半導体関連装置

半導体市場におきましては、AI技術の進化、世界的なEV（電気自動車）化へのシフト、IoTに求められる半導体の多様化など拡大基調が継続いたしました。半導体関連製造装置の需要につきましても、ウェーハ、デバイス生産メーカーなどによる増産対応の設備投資を中心に、好調に推移いたしました。

このような状況の中で当社グループは、ポリッシュ装置の重点販売、次世代パワー半導体用各種装置の販売増加に向けて、プロセス開発はもとより、商社開拓や展示会への積極的な参加などの諸施策を進めた結果、中国及び東アジアにおいて、ウェーハ生産用のファイナルポリッシャーやデバイス生産用のバックグラインダーなどの拡販につなげることができました。受注につきましても、ウェーハ生産用のファイナルポリッシャーが前期に続いて高水準で推移いたしました。

国内では、電子部品加工用のグラインダーやスライサーなどを販売し、ウェーハ生産用のファイナルポリッシャーを継続して受注するなど販売、受注ともに増加いたしました。

以上の結果、売上高は1,473百万円（前年同期比40.1%増）、セグメント利益（営業利益）は391百万円（前年同期比112.1%増）となりました。

## (2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して427百万円増加し、31,774百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金が1,626百万円が減少した一方で、現金及び預金が705百万円、たな卸資産が1,354百万円増加したことによるものであります。

当第1四半期連結会計期間末の負債の合計は、前連結会計年度末と比較して2,035百万円増加し、22,056百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が537百万円、短期借入金が1,626百万円増加したことによるものであります。

また、純資産は、前連結会計年度末と比較して1,607百万円減少し、9,718百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による増加346百万円、配当金の支払いによる減少221百万円により125百万円増加したこと及び、自己株式の取得1,700百万円によるものであります。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の36.1%から30.6%となりました。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績につきましては、平成30年5月15日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,512	4,217
受取手形及び売掛金	8,291	6,665
商品及び製品	1,883	2,114
仕掛品	3,510	4,618
原材料及び貯蔵品	2,588	2,603
その他	288	358
貸倒引当金	△33	△35
流動資産合計	20,040	20,542
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3,732	3,771
機械装置及び運搬具(純額)	2,304	2,290
その他(純額)	3,674	3,581
有形固定資産合計	9,712	9,642
無形固定資産	80	80
投資その他の資産		
投資有価証券	103	101
退職給付に係る資産	375	420
その他	1,080	1,034
貸倒引当金	△46	△46
投資その他の資産合計	1,513	1,509
固定資産合計	11,305	11,232
資産合計	31,346	31,774
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,179	4,716
短期借入金	7,511	9,137
1年内返済予定の長期借入金	1,394	1,210
未払法人税等	125	52
賞与引当金	379	237
製品保証引当金	50	46
その他	2,596	3,069
流動負債合計	16,236	18,470
固定負債		
長期借入金	2,112	1,939
退職給付に係る負債	692	696
資産除去債務	121	121
その他	857	827
固定負債合計	3,783	3,585
負債合計	20,020	22,056

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,880	4,880
利益剰余金	8,210	8,336
自己株式	△1,370	△3,070
株主資本合計	11,720	10,146
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	16	14
為替換算調整勘定	△587	△617
退職給付に係る調整累計額	176	175
その他の包括利益累計額合計	△394	△428
純資産合計	11,326	9,718
負債純資産合計	31,346	31,774

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)
売上高	5,675	6,871
売上原価	3,979	4,600
売上総利益	1,696	2,271
販売費及び一般管理費	1,593	1,745
営業利益	103	526
営業外収益		
受取利息	0	1
受取配当金	1	0
助成金収入	12	0
物品売却益	3	7
為替差益	18	19
その他	11	8
営業外収益合計	48	37
営業外費用		
支払利息	67	62
支払手数料	5	38
その他	11	11
営業外費用合計	83	113
経常利益	68	450
税金等調整前四半期純利益	68	450
法人税等	30	103
四半期純利益	37	346
親会社株主に帰属する四半期純利益	37	346

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
四半期純利益	37	346
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	4	△1
為替換算調整勘定	70	△29
退職給付に係る調整額	△0	△1
その他の包括利益合計	74	△33
四半期包括利益	111	313
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	111	313



## (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、平成30年5月15日開催の取締役会決議に基づき、自己株式416,100株の取得を行いました。この自己株式の取得等により、当第1四半期連結累計期間において自己株式が1,700百万円増加し、当第1四半期連結会計期間末において自己株式が3,070百万円となっております。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(セグメント情報等)

## 【セグメント情報】

## I 前第1四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	工作機械	半導体 関連装置	計		
売上高					
外部顧客への売上高	4,623	1,051	5,675	—	5,675
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	4,623	1,051	5,675	—	5,675
セグメント利益	126	184	311	△207	103

(注)1. セグメント利益の調整額△207百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

## II 当第1四半期連結累計期間(自平成30年4月1日至平成30年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	工作機械	半導体 関連装置	計		
売上高					
外部顧客への売上高	5,397	1,473	6,871	—	6,871
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	5,397	1,473	6,871	—	6,871
セグメント利益	343	391	734	△208	526

(注)1. セグメント利益の調整額△208百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

## 3. 補足情報

受注及び販売の状況

## (1) 受注状況

セグメントの名称	受注高 (百万円)	前年同期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同期比 (%)
工作機械	8,052	133.0	13,175	211.1
半導体関連装置	7,627	277.8	16,410	464.1
合計	15,679	178.2	29,585	302.6

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

## (2) 販売実績

セグメントの名称	販売高 (百万円)	前年同期比 (%)
工作機械	5,397	116.7
半導体関連装置	1,473	140.1
合計	6,871	121.1

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。